

公司代码：603186

公司简称：华正新材

浙江华正新材料股份有限公司  
2024 年年度报告摘要

## 第一节 重要提示

- 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网站仔细阅读年度报告全文。
- 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 公司全体董事出席董事会会议。
- 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

## 第二节 公司基本情况

### 1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	华正新材	603186	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	祝郁文	林金锦
联系地址	浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号	浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号
电话	0571-88650709	0571-88650709
传真	0571-88650196	0571-88650196
电子信箱	hzxc@hzcc1.com	hzxc@hzcc1.com

### 2、报告期公司主要业务简介

公司主营覆铜板(包括粘结片)、复合材料(包括功能性复合材料和交通物流用复合材料)和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售,产品均已通过中国 CQC、美国 UL 认证且符合欧盟 REACH、

ROHS 标准,并广泛应用于 5G 通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。根据国民经济行业分类与代码 (GB/T4754-2017),公司所处行业属于“C3985 电子专用材料制造业”。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(中国证监会公告[2012]31 号),属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。

### (一) 国家政策支持

2023 年 10 月,工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,鼓励存储产品制造企业持续提升关键存储部件等自主研发制造水平,打造存储介质、存储芯片、存储系统和存储应用相互促进、协同发展的产业生态。

2022 年 3 月,国务院《2022 年政府工作报告》,促进数字经济发展。加强数字中国建设整体布局。建设数字信息基础设施,逐步构建全国一体化大数据中心体系,推进 5G 规模化应用,促进产业数字化转型,发展智慧城市、数字乡村。加快发展工业互联网,培育壮大集成电路、人工智能等数字产业,提升关键软硬件技术创新和供给能力。

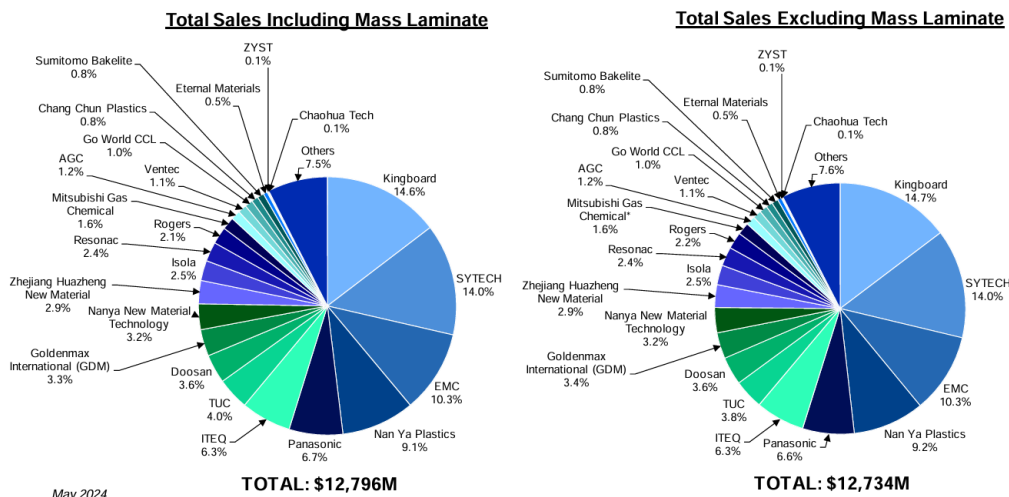
2022 年 2 月,国家发展改革委、工信部、财政部等部委《关于印发促进工业经济平稳增长的若干政策的通知》加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快 5G 建设进度,支持工业企业加快数字化改造升级,推进制造业数字化转型;启动实施北斗产业化重大工程,推动重大战略区域北斗规模化应用;加快实施大数据中心建设专项行动,实施“东数西算”工程,加快长三角、京津冀、粤港澳大湾区等 8 个国家级数据中心枢纽节点建设。

2021 年 3 月,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》,聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能;2021 年 12 月,工信部《“十四五”国家信息化规划》,完成信息领域核心技术突破,加快集成电路关键技术攻关。加强人工智能、量子信息、集成电路、空天信息、类脑计算、神经芯片、DNA 存储、脑机接口、数字孪生、新型非易失性存储、硅基光电子、非硅基半导体等关键前沿领域的战略研究布局和技术融通创新。

国家相关支持政策明确了集成电路行业在国民经济中的战略地位。上述政策和法规的发布和落实,从多个方面对集成电路行业给予了大力支持。受益于集成电路国产化进程的加速,以及智能化、人工智能、物联网、双碳经济、电动汽车、工业控制、5G 等应用对集成电路新应用需求的不断提升,行业发展潜力巨大。公司以覆铜板基础材料为基石,布局了高频、高速、高导热、HDI、BT 封装材料,并逐步实现稳定生产和交付,未来将聚焦资源提升该系列产品的营收占比,同时继续投入研发,实现产品的更新迭代,及时满足客户的需求。

### (二) 公司所处的行业现状

CCL 行业龙头市占率相对较高,2023 年 CR1、CR3、CR5、CR10 分别仅占 15%、39%、55%、75%,集中度较高,可见行业存在壁垒使得满足条件的竞争者做大。根据 Prismark 报告(如下图所示),公司 2023 年全球市场份额约 2.9%,排名第 11 位。



(一) 主要业务

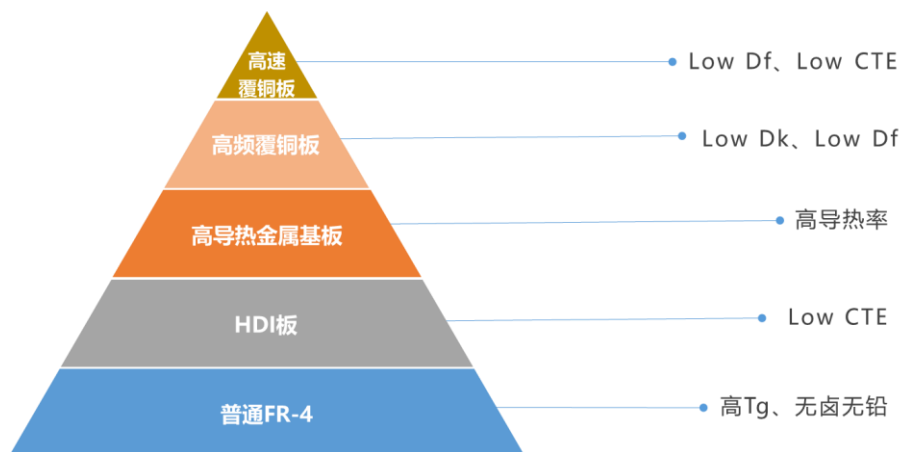
公司主要从事覆铜板及粘结片、复合材料和膜材料等产品的设计、研发、生产及销售，产品广泛应用于 5G 通讯、服务器、数据中心、半导体封装、新能源汽车、智慧家电、医疗设备、轨道交通、绿色物流等领域。

1. 公司主要产品覆铜板（CCL），是制作印制电路板（PCB）的基础材料。覆铜板是将玻璃纤维布或其它增强材料浸以树脂，一面或双面覆以铜箔或其他金属层并经热压而制成的一种板状材料，担负着印制电路板导电、绝缘、支撑三大功能，是一类专用于 PCB 制造的特殊层压板，以玻璃纤维布基双面覆铜板为例，其主要原材料为铜箔、玻璃纤维布、树脂等。

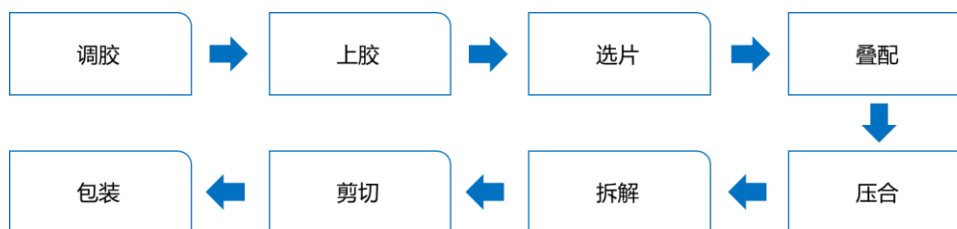
公司致力于技术的开发与迭代，覆铜板在实现“三高（高频、高速、高导热）”特性的同时，进一步推进“三低（Low Dk、Low Df、Low CTE）”技术指标的纵深发展。覆铜板产品的下游应用领域众多且有不同功能化需求，公司覆铜板产品分类如下：

类型	终端应用场景
普通FR-4	计算机及外围设备、通讯设备、汽车电子、消费电子、仪器仪表等
高速覆铜板	服务器、存储器、交换机、基站、路由器、汽车电子、高性能计算机等
高频覆铜板	基站天线、功放、毫米波雷达等
高导热金属基板	算力服务器散热配件、汽车电子、光电照明、电源管理、电机控制、功率模块等
HDI覆铜板	笔记本电脑、智能手机、可穿戴设备等

公司主要产品已逐步切换到高等级覆铜板，各类产品特性如下图所示：



覆铜板的工艺流程如下图：



2. 公司半导体封装材料包括 BT 封装材料和 CBF 积层绝缘膜，适用于 Chiplet、FC-BGA 等先进封装工艺，具体应用场景如下所示：

类型	应用场景
BT封装材料	Mini&Micro LED、Memory、MEMS、CPU/GPU等算力芯片等
CBF积层绝缘膜	CPU/GPU等算力芯片、手机用VCM音圈马达、手机主板等

(1) BT 封装材料，具有高耐热性、耐 CAF、低介电常数和低膨胀系数等多种优势，主要应用于在 Memory、Mini&Micro LED 等应用场景。

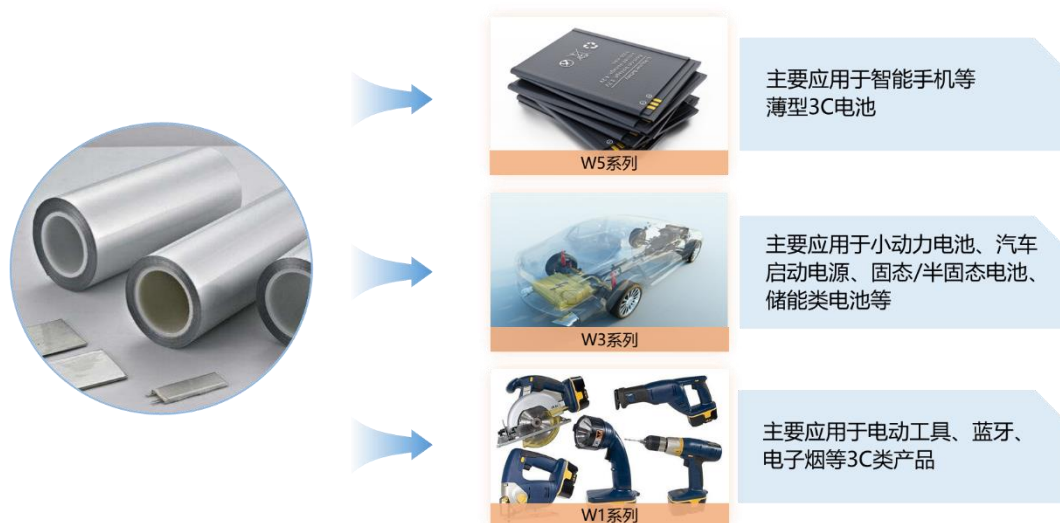
(2) CBF 积层绝缘膜是公司与深圳先进电子材料国际创新研究院合作开发的半导体封装材料，具有良好的介电性能、热膨胀系数、剥离强度、绝缘性能和可加工性能，可应用于 CPU/GPU 等算力芯片的半导体封装等。

3. 公司复合材料产品包括功能性复合材料和交通物流用复合材料。功能性复合材料是以玻璃纤维布或其他特种纤维为增强材料，浸渍或涂布树脂，并经过高温压制而成的一种复合材料，广泛应用于消费电子、电工电器、工业装备等；交通物流用复合材料是以聚丙烯树脂为原料，经过工艺成型制成蜂窝芯，并与玻纤等表面蒙皮材料经过高温压制复合而成的一种板状材料，具备轻质、高强、耐候的特点，广泛应用于新能源汽车、厢式货车、冷链物流等领域。具体如下所示：

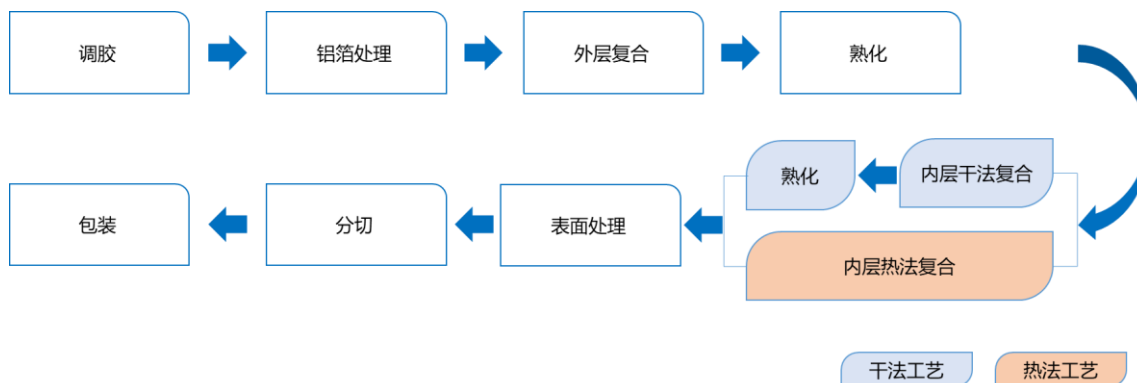
类型	产品系列	应用场景
功能性复合材料	绝缘层压板、绝缘加工件	电工电气、新能源汽车、医疗设备、手机后盖等
交通物流用复合材料	蜂窝系列	卡车车厢、封闭式拖挂车、房车、客车地板等
	厢板系列	冷藏车、房车、厢式货车、半挂车、拖挂车等
	厢车系列	冷链物流、干式货运、特种专用车等

4. 公司的铝塑膜产品，主要应用于软包锂电池的电芯封装，由外层尼龙层、中间铝箔层、内层热封层通过胶粘剂压合粘结而成，其在阻隔性、冲深、耐穿刺、耐电解液和绝缘性等方面均有严格要求，目前已被广泛应用于动力、3C 数码、储能等软包锂电池。相较于铝壳或钢壳等封装形式，铝塑膜作为封装材质更轻，且软包锂电池采用叠片工艺使得电池结构更紧密，大幅度提高了同等规格尺寸下软包锂电池的容量，是锂电池朝着轻量化、小体积发展的关键材料。

公司铝塑膜产品分为 W1 系列、W3 系列、W5 系列。具体如下所示：



铝塑膜工艺流程图如下图：



## （二）经营模式

### 1. 研发模式

根据战略目标，公司积极在高端电子材料、复合材料、膜材料等先进材料领域进行产品开发和工艺技术布局。

公司研判行业技术发展趋势，联合产业链上下游，开展技术与工艺研究与开发，并且与相关高校、科研院所积极开展产学研合作，开展材料的基础研究。

公司在所有事业部推行 IPD 集成产品开发模式，建成数字化集成开发平台，实现产品实现从需求、设计、生产、服务的全生命周期管理。

公司构建了强大的分析测试能力，为内部产品开发提供坚实保障，并为下游客户及终端客户提供所需的检测分析服务，可快速满足客户在分析测试上的需求。

同时，公司着重提升基础研究能力和研发质量管控能力，持续提升研发项目信息化水平，通过建立原材料数据库、经验沉淀及共享复用机制来强化基础研究，并围绕“验证能力平台”整合内部测试资源，构建工程师任职能力梯队，确保研发质量的同时提高研发的协同、效率及数据资料完整性、保密性、时效性。

### 2. 采购模式

公司致力于打造有韧性、可靠的采购供应链，建设基于战略合作的供应商伙伴关系。公司内部持续优化采购管理流程体系，搭建供应商管理信息化系统（SRM），实现价值采购和阳光采购。

在常规原材料方面，采购部门结合原材料需求计划、预测计划与市场供需情况，在充分询价、议价、比价的基础上，结合库存情况进行波段采购；在特种原材料方面，采购部门按 IPD 要求介入各开发项目，提供供应链方案。

在高速高频覆铜板、半导体封装材料、铝塑膜等战略产品方面，公司通过与上下游的战略合作与联合开发，实现相关产品关键原材料的国产替代和多元化选择，构建安全和可持续发展的采购供应链。

### 3. 生产模式

公司致力打造柔性生产体系，为客户提供多系列多层次产品，满足客户对品质、交期等差异化要求，实现端到端交付。

公司致力于智能工厂和未来工厂的建设，在青山湖基地和珠海基地，通过引入集成供应链管理（ISC）进行管理升级，依托流程、组织、信息的集成，驱动研发、生产、销售，实现跨区域协同管理和资源整合，实现生产制造各个环节的流程化管理。

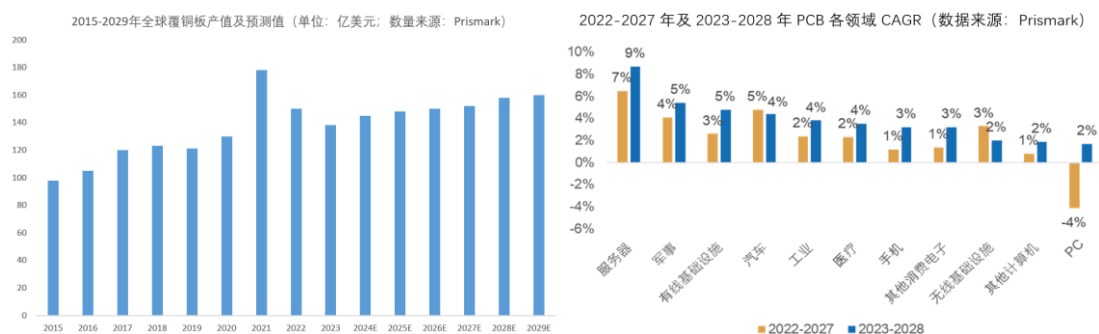
### 4. 销售模式

公司坚持以客户为中心，以市场为导向，以终端客户认证带动销售，全方位深入客户，挖掘客户需求和市场机会点，为客户提供多样化的产品应用解决方案，提高市场机会点转化成订单从而实现商业价值的能力。

公司集中优质资源全方位服务战略大终端和战略 PCB 大客户，聚焦汽车、通信、智能终端与模组三大产品领域，通过 3R 团队的有效协同，提升市场占有率和客户满意度。

## （三）行业情况说明

2024 年覆铜板行业仍然面临产能过剩，行业竞争加剧压力，但整体实现企稳止跌，同比 2023 年略有增长，特别是在 AI 等新型应用领域放量的带动下，行业呈现出结构性发展机会。



### 3、公司主要会计数据和财务指标

#### 3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减 (%)	2022年
总资产	6,112,559,946.57	5,792,327,848.49	5.53	5,640,233,303.50
归属于上市公司股东的净资产	1,455,270,701.47	1,550,966,280.22	-6.17	1,679,410,323.48
营业收入	3,864,746,361.04	3,361,517,062.05	14.97	3,285,504,596.23
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	3,778,353,928.28	3,295,062,219.98	14.67	3,235,666,265.22
归属于上市公司股东的净利润	-97,430,334.61	-120,518,795.21		36,079,871.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-118,608,754.86	-130,199,026.75		14,960,424.68
经营活动产生的现金流量净额	168,880,342.75	243,895,297.94	-30.76	387,807,006.19
加权平均净资产收益率 (%)	-6.48	-7.46	增加0.98个百分点	2.21
基本每股收益 (元/股)	-0.69	-0.85		0.25
稀释每股收益 (元/股)	-0.69	-0.85		0.25



## 3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	854,789,538.12	1,087,320,791.24	881,637,881.53	1,040,998,150.15
归属于上市公司股东的净利润	-992,739.80	10,965,288.09	-16,617,580.11	-90,785,302.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	633,760.04	10,605,380.29	-21,613,811.95	-108,234,083.24
经营活动产生的现金流量净额	-67,218,009.25	47,965,616.82	27,709,614.68	160,423,120.50

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 4、 股东情况

## 4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

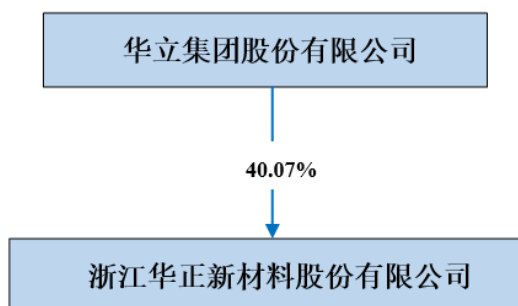
单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）							18,817
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）							19,922
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）							不适用
前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称 （全称）	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 （%）	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
华立集团股份有限公司	0	56,902,768	40.07	0	无	0	境内非 国有法 人
上海赤钥投资有限公司—赤钥 10 号私募证券投资基金	272,400	4,710,000	3.32	0	无	0	其他
朱立锋	1,567,183	3,574,283	2.52	0	无	0	境内自 然人
河北纵横集团丰南钢铁有限公司	1,713,567	1,713,567	1.21	0	无	0	境内非 国有法 人
郭江程	0	1,177,481	0.83	0	无	0	境内自 然人

							然人
叶红春	200,154	1,032,954	0.73	0	无	0	境内自然人
许利民	0	1,012,200	0.71	0	无	0	境内自然人
河北中重冷轧材料有限公司	990,200	990,200	0.70	0	无	0	境内非国有法人
刘涛	0	914,046	0.64	0	无	0	境内自然人
中国建设银行股份有限公司—华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金	365,100	889,900	0.63	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	除股东郭江程为公司控股股东华立集团董事外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

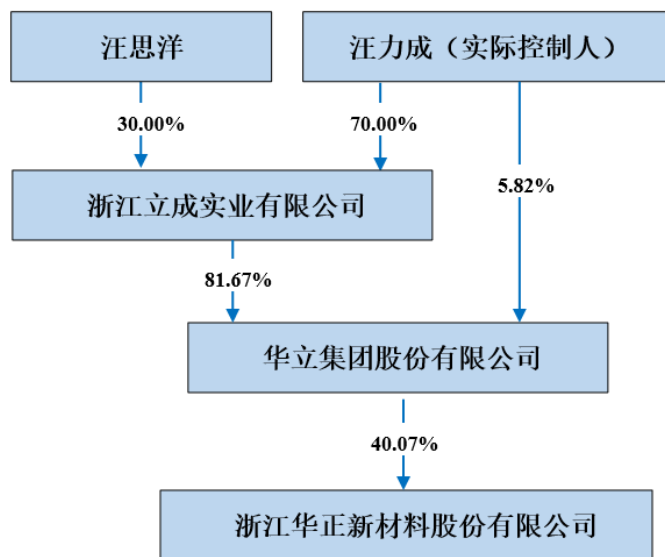
#### 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



#### 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

适用 不适用

#### 5、公司债券情况

适用 不适用

### 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024 年公司生产覆铜板 3,555.61 万张，比上年增长 20.18%；生产导热材料 174.97 万平方米，比上年下降 16.06%；生产功能性复合材料 1,380.53 吨，外协 889.79 吨，外购 7.79 吨，合计 2,278.11 吨，比上年上升 70.59%；生产交通物流用复合材料 201.79 万平方米，外协 0.99 万平米，合计 202.78 万平方米，比上年上升 1.91%；

销售覆铜板 3,530.44 万张，比上年上升 19.69%；销售导热材料 181.55 万平方米，比上年下降 8.18%；销售功能性复合材料 2,094.14 吨，比上年上升 45.62%；销售交通物流用复合材料 211.30 万平方米，比上年上升 3.60%。实现主营业务收入 3,778,353,928.28 元，比上年上升 14.67%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用